

## 产品特点

高精度胶片处理技术  
高性能，低温漂，大功率  
陶瓷基板，50Ω共面波导  
金丝键合，适用于多芯片集成模块

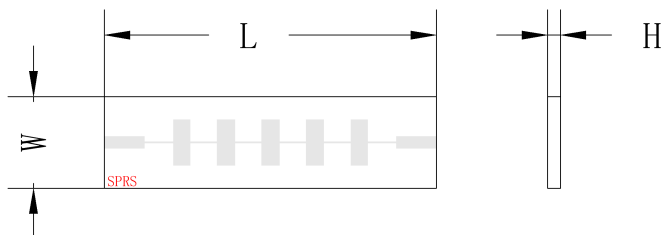
## 技术要求

| 项目    | 参数              | 单位  |
|-------|-----------------|-----|
| 中心频率  | 10.25           | GHz |
| 工作带宽  | DC-20.5         | GHz |
| 通带损耗  | 2.0             | dB  |
| 带内波动  | 2.0             | dB  |
| 驻波比   | 1.7:1           |     |
| 群时延波动 | 0.4             | ns  |
| 带外抑制  | 30@27.0-43.0GHz | dBc |

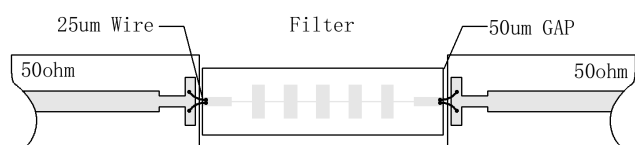
## 其它要求：设计保证

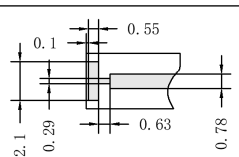
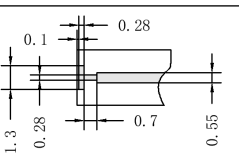
|      |                              |
|------|------------------------------|
| 承受功率 | 1W CW                        |
| 工作温度 | -55 ~ +85°C                  |
| 储存温度 | -55 ~ +125°C                 |
| 外形尺寸 | L : 3.0 , W : 2.0 , h : 0.26 |

## 外形图：端口居中



## 推荐装配图



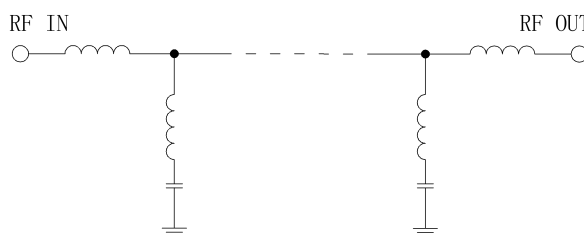
|                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PCB Rogers5880, h:0.254mm                                                           | PCB Rogers4350B, h:0.254mm                                                          |
|  |  |

## 注意事项

- 1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
- 2：标贴式滤波器；芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
- 3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数（6.7ppm / °C）,载体厚度 ≥ 0.2mm;
- 4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;



## 原理图



## 典型曲线

